

物質·材料

Cu 添加 Mn₄N の Cu 磁気モーメントの反転と 磁化補償の検討

SATテクノロジー・ショーケース2024

■ はじめに

Mn₄N薄膜は垂直磁気異方性と小さな磁化を併せ持ち、 電流駆動磁壁移動を利用したデバイスの候補材料として 注目されている。Mn₄N系混晶では不純物の添加量を制 御し、特定の組成で磁化が極小値をとる磁化補償という特 異な現象も確認されている^[1]。この磁化補償は磁壁移動の 効率を爆発的に向上させ、Ni添加Mn₄Nでは磁化補償組 成付近で3,000 m/s(電流密度 1.2×10¹² A/m²)という、室温 かつ磁場を使わない条件では世界最速の記録を達成した ^[2]。今回、バルク結晶での磁化補償が示唆されていたCu 添加Mn₄N (Mn_{4-x}Cu_xN)^[3]に注目し、分子線エピタキシー を用いて高品質なMn_{4-x}Cu_xN薄膜を作製した。さらに、試 料振動型磁力計(VSM)を用いた磁化測定およびX線磁 気円二色性測定(XMCD)による磁気構造の同定を行い、 Mn_{4-x}Cu_xN薄膜の磁化補償の可能性を検討した。

■ 実験方法

分子線エピタキシー法によりSrTiO₃[STO](001)基板上 に~23 nmのMn_{4-x}Cu_xN(x = 0.0-0.5)薄膜を作製した。作製 した薄膜に対し、磁場を面直に印加してVSMによる室温 での磁化測定を行った。薄膜の磁気構造はKEK Photon Factory BL-16にて5 Tの磁場を印加しながら軟X線を照射 し、室温でのCuの $L_{2,3}$ 吸収端におけるX線吸収スペクトル (XAS)およびXMCD測定を行い評価した。なお、磁場/軟 X線は面直方向から約55°傾いた方向から印加/照射した。 また、XAS•XMCDの信号は蛍光収量法により取得した。

■ 結果·考察

STO基板上に作製した $Mn_{4-x}Cu_xN$ 薄膜の飽和磁化の組 成x依存性をFig. 1に示す。xに対して飽和磁化が減少して いき、x = 0.3-0.5で極小値を示している。なお、x = 0.4に関 しては磁化が著しく小さくなり、VSMの感度を超え計測不 可であった。そのため、 $x \sim 0.4$ で、反平行を向いている磁 気モーメント同士の大部分が打ち消しあっていると考えら れる。続いて、 $Mn_{4-x}Cu_xN((a)x=0.3, (b)x=0.4)$ 薄膜のCu- $L_{2,3}$ 吸収端においてのXAS・XMCD(XASプロファイルは 正規化している)をFig. 2に示す。XASプロファイルに関し ては、この2つの組成で大きな違いが見られなかった。こ れは、添加されたCuの価数が変化していないことを示唆し ている。XMCDプロファイルを見ると、Fig. 2(a)の $Mn_{3.7}Cu_{0.3}N$ では934 eV、955 eVにそれぞれ正、負のピー クが現れた。一方で、組成xを大きくしたFig. 2(b)の

代表発表者	旗手	蒼(はたて	こ あおい)	

所属	筑波大学大学院 応用理工学学位:	数理物質科学研究群 プログラム
BB A		—

問合せ先 〒305-0005 茨城県つくば市天王台 1-1-1 TEL:029-853-5472 Mn_{3.6}Cu_{0.4}Nでは、それら2つのピークの符号反転が起きた。 XMCDプロファイルのピークの向きは、その原子の磁気モ ーメントの配列を反映していると考えられる。そのため、Cu の添加量を増やしていくと、x = 0.3-0.4間のある組成でCu の磁気モーメントが反転するといえる。磁化補償を示す場 合に見られる特徴である、磁化の極小値および磁気モー メントの反転が同時に確認されたため、私たちは Mn_{4-x}Cu_xN薄膜が室温で組成による磁化補償を示す可能 性が高いと考える。

■ 参考文献

- [1] T. Komori et al., J. Appl. Phys. 127, 043903 (2020).
- [2] S. Ghosh et al., Nano Lett. 21, 2580 (2021).
- [3] R. Zhang et al., Acta Mater. 234, 118021 (2022).







Fig. 2 .XAS and XMCD spectra in (a) Mn_{3.7}Cu_{0.3}N and (b) Mn_{3.6}Cu_{0.4}N films at Cu-*L*_{2.3} edges (XAS are standardized.)

